



ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Digi International bringt sein Fachwissen über das IoT und Edge Computing zur electronica 2018 in München

Digi präsentiert Digi XBee3 Cellular und Lösungsvorführungen auf dem erstklassigen Branchenevent für eingebettete Technologien

MÜNCHEN, 5. November 2018 – Digi International®, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und –dienstleistungen für das Internet der Dinge (eng. *Internet of Things – IoT*) hat heute die Vorstellung der Smart Edge IoT Module und Modems aus seiner Produktserie Digi XBee3® auf der electronica 2018 in München, Deutschland, angekündigt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Digi XBee3 Cellular mit NB-IoT. Digi wird seine Lösungen bei mehreren Vorführungen der neuesten eingebetteten Technologien zur Schau stellen und sein Fachwissen durch die Leitung verschiedener Schulungssitzungen weitergeben. Die electronica findet vom 13. bis 16. November 2018 auf dem Messegelände der Messe München statt. Digi wird in Halle B5 am Stand 263 ausstellen.

Die Produktserie Digi XBee3 wurde entwickelt, um IoT-Innovationen und Rechenleistung am Netzwerkrand zu unterstützen. Digi XBee3 bietet MicroPython-Programmierbarkeit und Dual-Mode-Funkgeräte und kann per Software-Upgrade auf Bluetooth LE aufgerüstet werden, wodurch die Verbindung lokaler Geräte über ein Smartphone oder Tablet ermöglicht wird. Digi XBee3 nutzt einen modularen Ansatz zur IoT-Konnektivität, der Optionen für Zigbee, WLAN oder Mobilfunk umfasst, einschließlich LTE-M und NB-IoT. Digi XBee3 ermöglicht innovative IoT-Lösungen, die schneller entwickelt, prototypisiert und in Serie produziert werden können, um eine optimale Investitionsrentabilität zu erzielen.

Diese Lösungen können mit Digi XCTU® und Digi Remote Manager® (DRM), der zentralen, sicheren Plattform für die Geräteverwaltung von Digi, eingesetzt, bereitgestellt und überwacht werden. DRM bietet nicht nur Einblicke in den Geräte- und Netzwerkzustand, sondern automatisiert Updates, greift auf Daten direkt vom Rand zu und integriert Daten in offene APIs, um den Benutzern tiefere Einblicke zu ermöglichen.

Darüber hinaus zeigt Digi eine Vorschau seiner Digi ConnectCore® 8X System-On-Module (SOMs) und SBCs. Digi ist Early Access Partner von NXP und das äußerst kleine Modul nutzt die Prozessorfamilie NXP i.MX 8X, die auf ARM® Cortex®-A35- und Cortex-M4F-Kernen basiert.

„Die Besucher der electronica erwarten nicht nur neue Technologien, sondern wollen auch herausfinden, wie sie ihnen bei der Lösung ihrer geschäftlichen Herausforderungen helfen

können“, erklärt Chris Bowen, Vizepräsident für EMEA von Digi International. „Digi erfüllt Verbindungs- und Netzwerkanforderungen mit einer umfassenden Palette an eingebetteten Hardware-Optionen, einer Software, die speziell für die Optimierung von IoT-Anwendungen entwickelt wurde und Expertendienstleistungen, die den Erfolg des Kunden gewährleisten. Digi verbindet nicht nur die Dinge im IoT, wir bieten auch Daten, Einblicke und Management-Tools, um die Leistung zu maximieren und die Wertschöpfung zu steigern.“

Produktvorführungen

- **Remote-IoT-Konnektivität mit Digi XBee3 Cellular:** In dieser Vorführung wird die Verwaltung entfernter Geräte mit einem Digi XBee3 Cellular Gerät und dem Cloud-basierten Digi Remote Manager veranschaulicht, indem Geräte an mehreren Standorten direkt von der Messehalle aus fernüberwacht und -gesteuert werden.
- **Digi XBee3 End-to-End IoT Networking:** Digi stellt die neuesten Entwicklungen der Plattform Digi XBee3 vor, einschließlich der Multi-Protokoll-Unterstützung (Zigbee, CAT-1, LTE-M, NB-IoT + Bluetooth LE) mit einer IoT-Netzwerklösung aus Digi XBee3-Modulen, Digi XBee Industrial Gateways und Tools zur Netzwerk- und Geräteverwaltung. Diese Updates bieten neue Anwendungsmöglichkeiten für eine verbesserte Installation, lokale Steuerungsdiagnose und Konfiguration. Das Netzwerk- und Geräteverwaltungselement verwendet eine neue XCTU® mobile Anwendung für die Konfiguration von Digi XBee über ein Telefon oder Tablet.
- **SteadyServ iKeg:** Diese Anwendungsdemonstration zeigt, wie SteadyServ iKeg Sensoren zur Messung des Fassvolumens nutzt, Daten lokal mit einem Digi ConnectPort-Gateway analysiert und die Analyse anschließend über eine Zigbee-Verbindung in die Cloud sendet. Die Anwendung iKeg stellt Barmanagern die Cloud-basierten Informationen zur Verfügung, damit sie eine genaue Bestandsaufnahme vornehmen und auf eigene Initiative mehr bestellen können, wenn das Bier knapp wird.

Schulungssitzungen

- **Auswahl der LPWAN-Mobilfunktechnologie für das IoT:** Präsentiert von Mark Tekippe, internationalem Geschäftsführer für Produktmanagement, eingebettete Technologien und RF von Digi International, am Mittwoch, 14. November. Im Rahmen des Themenbereichs IoT wird in dieser Sitzung die Auswahl der besten Konnektivitätstechnologie für Anforderungen an geringem Stromverbrauch und geringer Bandbreite im IoT sowie LTE Cat 1, LTE-M, NB-IoT und Weiteres angesprochen.
- **Was ist Edge Compute?:** Präsentiert von Andreas Burghart, Ingenieur für Lösungsvertrieb von Digi International, am Donnerstag, 15. November. Im Rahmen des Themenbereichs Maschinelles Lernen befasst sich diese Sitzung damit, wie die bestehende IT-Infrastruktur einen verschiedenen Denkansatz erfordert, um Intelligenz an den Rand des Netzwerks zu bringen. Zu den Prüfsteinen zählen die intelligente Erweiterung der Rechenleistung, die Erschließung neuer Möglichkeiten und Einnahmequellen mit mehr Rechenleistung und eine schnellere Markteinführung.
- **Yocto Project Linux als Plattform für die Entwicklung eingebetteter Systeme:** Präsentiert von Alex Gonzalez, Leiter der Softwareentwicklung von Digi International,

am Donnerstag, 15. November. Im Rahmen des Themenbereichs Software befasst sich diese Sitzung mit einer Vielzahl von Fragen bei der Auswahl eines Betriebssystems für ein eingebettetes System, einschließlich der Anschaffungskosten, Verfügbarkeit von Quellcodes und Unterstützung der breiten Architektur. All diese Faktoren führen zu einer deutlich verbesserten Markteinführungszeit und zur Verringerung des Risikos und Aufwands bei der Entwicklung der Plattform.

Mitaussteller und Partnerbeteiligung

Neben seinem eigenen Stand stellt Digi seine Lösungen auch im gesamten Veranstaltungsort zusammen mit seinen Partnern Mouser (Halle C3, Stand 550), Digi-Key Electronics (Halle B5, Stand 165), Atlantik (Halle C4, Stand 222), CODICO (Halle C4, Stand 402), Avnet Silica (Halle C5, Stand 101) und Arrow (Halle C4, Stand 412) vor.

- **Informationen zum jeweiligen Stand**

- Mouser zeigt die XBee XGI Industrial Gateways von Digi und das Digi XBee & Silicon Labs Giant Gecko Kit in seiner Vorführung der virtuellen Realität „Städte der Zukunft“ in den Abteilungen Digital Twinning und Smarter Edge.
- Am Stand von Atlantik wird ein ConnectCore 8X vorgestellt.
- CODICO zeigt an seinem Stand TransPort- und NB-IoT-Module von Digi.

Klicken um zu Tweeten

@DigiDotCom bringt #IoT Fachwissen, Edge Computing und Schulungssitzungen, bei denen die führenden Experten ihre Gedanken zum Thema teilen, zur @electronicaFair 2018 in Halle B5 am Stand 263. Lesen Sie mehr über die Highlights dieser erstklassigen Veranstaltung der #Embedded Technology auf <https://ctt.ac/a8G19> #ele18 #ConnectWithConfidence #DigiXBee3

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.Digi.com/xbee3

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als 100 Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international).

Anmerkungen für Redakteure

Um ein Interview oder ein Produktbriefing mit einem Digi-Manager während der Electronica 2018 zu vereinbaren, setzen Sie sich bitte mit Anthony Hildebrand oder John Waite unter Verwendung der nachfolgenden Angaben in Verbindung.

Pressekontakt:

Europa

Anthony Hildebrand oderr John Waite

Catalyst For Content

Geschäftsstelle: +44 (0) 1753 648140

anthony@catalystforcontent.com, john@catalystforcontent.com

Nordamerika

Joseph Rigoli

LEWIS

Geschäftsstelle: +1 781-418-2400

Digi@teamlewis.com